

证券代码：300460

证券简称：ST 惠伦

公告编号：2026-022

广东惠伦晶体科技股份有限公司

关于 2026 年度公司对外借款及相关授权事宜的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别风险提示：

广东惠伦晶体科技股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司提供担保总额超过最近一期经审计净资产 100%，本次担保含公司对资产负债率超过 70%的全资子公司担保金额超过公司最近一期经审计净资产 50%，公司对本次担保对象经营管理、财务等各方面均能有效控制，担保风险可控，敬请广大投资者关注。

公司于 2026 年 4 月 28 日召开第五届董事会第十次会议，审议通过了《关于 2026 年度公司对外借款及相关授权事宜的议案》。现将具体情况公告如下：

一、申请授信及相关担保情况的概述

鉴于公司业务扩展需要，提高公司生产经营运作效率，做好资金保障，公司（含子公司）拟向各类金融机构、融资租赁机构及其他第三方（不含关联方）申请累计不超过人民币 10 亿元的综合授信额度。另外，为顺利推动公司生产经营过程中的融资计划，公司拟为子公司的融资提供合计人民币不超过 8 亿元的担保额度，前述担保额度包含：公司为子公司提供担保；子公司为本公司提供担保；子公司之间的相互担保。

现提请授权董事长或董事长指定的代理人，在上述 10 亿元的综合授信额度以及 8 亿元的担保额度内，根据实际经营需要决定每一笔授信或担保的具体事宜，代表公司办理相关手续，签署相关法律文件（包括但不限于授信、借款、质押、抵押、融资等相关的合同、协议、凭证等各项法律文件）。由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。具体授信及担保事宜以实际签署的法律文件为准。

上述授权期限自本议案经股东会审议通过之日起至 2026 年度股东会召开之日止。超过上述综合授信额度及担保额度的部分，仍需按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》，《公司章程》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件

等规定的审议权限提交董事会或股东会审议。

本议案审议通过后尚需提交 2025 年度股东会审议，并需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

担保预计基本情况如下：

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期经审计资产负债率	截至 2025 年 12 月 31 日担保余额 (万元)	本次授权的担保额度 (万元)	担保额度占上市公司最近一期经审计净资产比例	是否关联担保
广东惠伦晶体科技股份有限公司	广州创想云科技有限公司	100%	30.32%	1346.8	3000	6.41%	否
广东惠伦晶体科技股份有限公司	东莞惠伦晶体器件工程技术有限公司	100%	61.30%	0	1000	2.14%	否
广东惠伦晶体科技股份有限公司	惠伦晶体（重庆）科技有限公司	100%	71.61%	32000	50000	106.87%	否
广东惠伦晶体科技股份有限公司	惠伦晶体科技（深圳）有限公司	100%	98.26%	2000	6000	12.82%	否

二、被担保人基本信息

（一）广州创想云科技有限公司

公司名称：广州创想云科技有限公司

统一社会信用代码：91440101633202999B

类型：有限责任公司(法人独资)

法定代表人：潘毅华

注册资本：3000万人民币

成立日期：1997年5月20日

注册地址：广州市天河区中山大道西89号2层201号

经营范围：工程和技术研究和试验发展；安全系统监控服务；安防设备销售；安防设备制造；电子、机械设备维护（不含特种设备）；服务消费机器人销售；环境保护专用设备销售；合同能源管理；在线能源监测技术研发；节能管理服务；大数据服务；通信设备销售；软件销售；软件开发；消防技术服务；消防器材销

售；电工器材制造；信息技术咨询服务；信息系统运行维护服务；信息系统集成服务；电力电子元器件销售；电子（气）物理设备及其他电子设备制造；物联网技术服务；物联网应用服务；物联网设备销售；网络技术服务；电气信号设备装置销售；机械电气设备销售；智能无人飞行器销售；安全技术防范系统设计施工服务；租赁服务（不含许可类租赁服务）；消防设施工程施工。

主要财务数据：

单位：元

项目	2025年12月31日(已审计)	2024年12月31日(已审计)
资产总额	89,259,162.23	97,384,999.73
所有者权益	62,195,143.94	70,428,412.87
归属于母公司所有者权益	62,195,143.94	70,428,412.87
项目	2025年1-12月(已审计)	2024年1-12月(已审计)
营业收入	26,010,176.87	33,592,233.20
净利润	-8,233,268.93	-1,080,461.39

经核查，广州创想云科技有限公司不属于失信被执行人。

（二）惠伦晶体（重庆）科技有限公司

公司名称：惠伦晶体（重庆）科技有限公司

统一社会信用代码：915500110MA60Y86A50

类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：韩巧云

注册资本：人民币22000万元

成立日期：2020年6月2日

注册地址：重庆市万盛经开区鱼田堡高新技术产业园

经营范围：一般项目：电子专用材料研发；物联网技术研发；智能控制系统集成；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；电子元器件制造；光电子器件制造；其他电子器件制造；电子元器件与机电组件设备销售；电力电子元器件销售；光电子器件销售；住房租赁。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

主要财务数据:

单位: 元

项目	2025年12月31日(已审计)	2024年12月31日(已审计)
资产总额	894,331,143.28	1,107,331,401.64
所有者权益	253,861,087.90	328,896,195.00
归属于母公司所有者权益	253,861,087.90	328,896,195.00
项目	2025年1-12月(已审计)	2024年1-12月(已审计)
营业收入	309,443,783.69	246,144,422.90
净利润	-105,361,690.05	-89,730,309.95

经核查,惠伦晶体(重庆)科技有限公司不属于失信被执行人。

(三) 东莞惠伦晶体器件工程技术有限公司

公司名称: 东莞惠伦晶体器件工程技术有限公司

统一社会信用代码: 91441900093124132W

类型: 有限责任公司(外商投资企业法人独资)

法定代表人: 赵积清

注册资本: 人民币1000万元

成立日期: 2014年02月28日

注册地址: 东莞市黄江镇黄江东环路68号

经营范围: 一般经营项目: 电子元器件的研发、设计、生产与销售。 许可经营项目: 无(一般经营项目可以自主经营;许可经营项目凭批准文件、证件经营)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

主要财务数据:

单位: 元

项目	2025年12月31日(已审计)	2024年12月31日(已审计)
资产总额	4,241,718.40	46,632,642.81
所有者权益	1,641,618.97	1,055,324.50
归属于母公司所有者权益	1,641,618.97	1,055,324.50

项目	2025年1-12月 (已审计)	2024年1-12月 (已审计)
营业收入	3,490,155.71	1,467,860.11
净利润	586,294.47	457,789.92

经核查，东莞惠伦晶体器件工程技术有限公司不属于失信被执行人。

(四) 惠伦晶体科技(深圳)有限公司

公司名称：惠伦晶体科技(深圳)有限公司

统一社会信用代码：91440300MA5GLXT85H

类型：有限责任公司

法定代表人：韩巧云

注册资本：500万元人民币

成立日期：2021年02月23日

注册地址：深圳市南山区粤海街道科技园社区琼宇路10号澳特科兴科学园B栋1006

经营范围：国内贸易（不含专营、专卖、专控商品）；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。
机械设备、五金产品、电子产品批发、销售。无。

主要财务数据：

单位：元

项目	2025年12月31日 (已审计)	2024年12月31日 (已审计)
资产总额	94,450,171.71	86,846,647.74
所有者权益	1,641,316.19	1,053,176.32
归属于母公司所有者权益	1,641,316.19	684,564.61
项目	2025年1-12月 (已审计)	2024年1-12月 (已审计)
营业收入	83,495,782.87	109,520,157.10
净利润	588,139.87	-1,894,920.21

经核查，惠伦晶体科技(深圳)有限公司不属于失信被执行人。

三、对公司的影响

本次公司申请对外借款授信额度及相关授权事宜,是为了满足公司的经营资金需求,提高公司生产经营运作效率,不会对公司日常经营产生不利影响,同时有利于公司持续、健康、稳定发展,对公司的经营活动产生积极影响,风险可控,符合公司和股东的利益需求,不存在损害公司以及股东特别是中小股东利益的情形。

四、担保的主要内容

上述综合授信及担保额度经股东会通过前提下,授权公司董事长或董事长指定的代理人根据实际经营需要决定每一笔授信或担保的具体事宜,代表公司办理相关手续,签署相关法律文件。上述计划综合授信及担保额度仅为公司及子公司拟申请的综合授信额度和担保额度,具体授信额度及担保内容以实际签署的合同为准。

五、累计担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日,本公司及子公司的实际担保余额为 65,550.00 万元,占公司 2025 年经审计净资产的 140.10%。除前述外,公司及子公司无其他对外担保及逾期对外担保的实际数额。

六、董事会意见

董事会认为:为提高公司生产经营运作效率,公司向各类金融机构、融资租赁机构及其他第三方(不含关联方)申请累计不超过人民币 10 亿元的综合授信额度,并为融资提供合计人民币不超过 8 亿元的担保额度,有利于公司及子公司生产经营过程中融资计划的顺利推进,不会对公司产生不利影响,不会影响公司持续经营能力;公司对子公司日常经营具有绝对控制权,担保风险可控。

七、独立董事意见

独立董事认为:公司向各类金融机构、融资租赁机构及其他第三方(不含关联方)申请累计不超过人民币 10 亿元的综合授信额度,并为融资提供合计人民币不超过 8 亿元的担保额度,有利于公司及子公司生产经营过程中融资计划的顺利推进,不会对公司产生不利影响,不会影响公司持续经营能力;公司对子公司日常经营具有绝对控制权,担保风险可控。综上所述,我们一致同意公司本次对

外借款及相关授权事宜。

八、备查文件

- 1、第五届董事会第十次会议决议；
- 2、第五届董事会独立董事 2026 年第二次专门会议决议。

特此公告。

广东惠伦晶体科技股份有限公司董事会

2026 年 4 月 29 日